

ISOFIL AW 21

(REF: K50938/K5)

ISOFIL AW 21 eignet sich für hochbeanspruchte Schweissverbindungen an sauerstofffreiem Kupfer sowie Cu-Werkstoffen. Sehr gute Verarbeitbarkeit und porenfreie Schweissnähte. Beim WIG-Schweissen von grossen Werkstücken ist ein Vorwärmen auf 300° C zu empfehlen.

Normung und Zusammensetzung

ISO 24373	CuSn1 Cu1898
Cu	Rest
Sn	0,75 - 0,90
Mn	0,15 - 0,30
P	0,005 - 0,020
Si	0,15 - 0,25
Sonst.	max. 0,5

Physikalische Eigenschaften

Dichte (kg/dm³)	8,9
Schmelzbereich (°C)	1020 - 1050
Wärmeleitfähigkeit (W / m x K)	120 - 145
Längenausdehnungskoeffizient (10⁻⁶/K)	18,1
Elektrische Leitfähigkeit (m / Ω x mm²)	15 - 20
Spez. elekt. Widerstand (Ω x mm² / m)	0,05 - 0,0667

Mechanische Gütewerte der Schweißverbindung, Richtwerte

Wärmebehandlung	unbehandelt
Zugfestigkeit (MPa)	220
Bruchdehnung (%)	30
Brinell-Härte (HB 2,5/62,5)	60
Kerbschlagarbeit (Av (J))	75

Liefermöglichkeiten

Aufmachung	Gewicht/Länge	Abmessungen
Fass / bedrabox	175 - 200 kg	0,80 - 1,60 mm
SD300 / BS300 / K300	12 - 15 kg	0,80 - 2,40 mm
H500 / H560 / H760	150 - 250 kg	0,80 - 2,40 mm
Ringe	25 - 100 kg	1,60 - 6,00 mm
Stäbe	250 - 3000 mm	1,60 - 6,00 mm